MatriX X2在线式X射线自动检测系统

产品名称	MatriX X2在线式X射线自动检测系统
公司名称	北京锐峰先科技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MatriX 型号:MatriX X2
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

MatriX X2在线式X射线自动检测系统

透射 & 3D SFT

X2是一种先进的在线式x射线检测系统，它很好满足了当前生产线高速自动化检测的需求。

它利用透射式x射线技术结合Slice-Filter-Technology(SFT)技术很好地解决了双面PCB装联及其元件的检测问题。

X2 #的全自动检测应用CAD编制检查表来建立完备的检测模型库。

它的运动系统以及图像采集系统专门为满足高速化检测而设计。

X2 可进行离线编程。MIPS Tune就是其离线编程软件。它可实现自动CAD导入，CAD编辑及相关参数及检测方法的设定等。

所有的检测覆盖结果可被优化，分析及平衡处理。相关数据汇入专用的检测数据库。

MIPS_Process中的MIPS_Verify模块通过闭环纠错的方式，使用形象的图形及检测图像来验证检测对象有无缺陷，离线或在线状态都可进行。

此软件可与AOI系统平台结合使用。

MIPS_SPC 实时模块提供可即刻产线反馈的实时工艺控制。

系统特点

高速AXI系统扫描速度Max 6帧/秒. (5 平方英寸/秒)

透射式X射线技术结合3D Slice-Filter-Technology （SFT）

在线式传送轨道可自动调宽

微焦距X射线管（闭管）Max: 130kV

双重3/2英寸影像接收器

曝光时间可调的数码相机（1k x 1k ）

视野可变的3轴可编程运动系统

图像自动灰阶及几何学调校

产品型号及序列号的条形码扫描(1D/2D)

图像处理特点

MIPS 硬件：

多核芯电脑工作站

Windows 7系统

MIPS 检测平台：

先进的运算库应对焊点及元件检测

Slice-Filter-Technique应对双面板工艺

自动树状分类（ATC）以生成相应规则

可显示测试范围及自动程序生成的离线编程软件

验证及制程控制

MIPS_Verify link 闭环维修控制

MIPS_Process实时SPC统计

应用

电子元器件和焊点检测

利用其拥有的先进运算库对电子领域及其PCBA的元件及焊点，混合装配或芯片级装配工艺进行有效的检测

所有SMD及插件标准元件

BGA and QFN封装的特别运算

冷却片/散热片的焊接空洞检测

规格

物理参数

外形尺寸： 60.5" (H) x 71" (W) x 62" (D) / 1550 mm (H) x 1800 mm (W) x 1600 mm (D)

传送轨道高度可调： Max950 mm (SMEMA)

重量： 7700 lbs. (3500 kg)

安全环境温度： 60 ° to 90 ° F (15 ° to 32 ° C)

电源功率： max 6 kW

电源电压： 400 VAC, 50/60 Hz 3 phase, 16A 或 208 VAC, 50/60 Hz 3 phase, 25 A

外接气源： 5-7 bar, < 2 l/min, 滤芯 (30 μ), 干燥无油

运动系统

高速线性驱动样品台

行程范围： 510 x 405 mm

定位精度： +/- 5 μ m

Z轴： X射线管Z轴运动以连续调整放大倍率

X射线

管电压及管功率： 130 kV / 16 W

功率： 功率可调

光点大小： 5 μm

射线管定位： End window tube

影像接收器

接收器类型： 3" / 2" 图像增强器

相机： 1028 x 1028 像素, 10 bit

视频输出： Camera link interface

图像显示： 19"高分辨率TFT屏

图像性能

检测区域

最大板尺寸： 18" (X) x 14" (Y) 460 mm (X) x 360 mm (Y)

最大检测区域： 18" (X) x 14" (Y) 460 mm (X) x 360 mm (Y)

视场分辨率

视场尺寸： 0.4" (10 mm) to 1.0" (25 mm)

空间分辨率： 20 LP / mm at min. FOV (7.5% MTF)

装配间隙

顶部 (包括板厚)： 30 mm

底部 (除去板厚)： 30 mm